

放熱材料・基板・デバイスの 技術・市場展望-2016-

<調査のポイント>

◆放熱材料・基板・デバイス(16品目)の市場規模、及び市場規模推移予測

- 製品概要／分類、アプリケーション別採用状況
- 主要参入企業(参入製品など)
- 市場規模(2015年;タイプ別、アプリケーション別、メーカーシェア)
- 市場規模予測(2015年~2020年)
- 主要メーカーの事業動向、技術動向
- 製品の価格帯

◆アプリケーション動向

- ・LED照明、IGBTモジュール、HEV/EV用パワーコントロールユニット(PCU)

◆メーカー事例研究(30社)

■ 発刊日: 2016年8月25日

■ サイズ／ページ数: A4判／271ページ

■ 価格(税別): 160,000円(レポート)、180,000円(レポート+CD)

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-10-14 サンライズ橋2F
株式会社 ジャパンマーケティングサーベイ
TEL:03-5641-2871 FAX:0120-052-807
URL) <http://www.jms21.co.jp>

■ 目次

放熱技術が、電子機器の性能・品質を左右する (2)

第1章 総論

- 1.調査対象製品の定義・範疇等 (7)
- 2.放熱材料・基板・デバイスの全体市場規模(2015年) (8)
- 3.各種放熱材料・基板・デバイスのメーカシェア(2015年)-金額ベース- (10)
- 4.放熱材料・基板・デバイスの市場規模推移予測(2015~2020年)-金額ベース- (14)
- 5.放熱材料・基板・デバイスの全体市場規模(2015年、2020年)-金額ベース- (17)
- 6.各種放熱材料・基板・デバイスの市場の成長要因/市場背景 (18)
- 7.各種放熱材料・基板・デバイスの技術トレンド (20)
- 8.放熱材料・基板・デバイスの今後の有望アプリケーション (22)
- 9.各種放熱材料・基板・デバイスの製品価格帯 (23)

第2章 放熱材料・基板・デバイスの市場動向

- ・サーマルインターフェース材料(TIM) (26)
- ・高熱伝導シート (34)
- ・グラファイトシート (52)
- ・高熱伝導樹脂 (62)
- ・高熱伝導封止材 (73)
- ・放熱CEM-3基板材料(熱伝導基板材料) (77)
- ・アルミナフィラー(Al_2O_3 フィラー)-放熱用- (82)
- ・窒化ホウ素フィラー(h-BNfフィラー)-放熱用- (90)
- ・窒化アルミニウムフィラー(AlN フィラー)-放熱用- (99)
- ・メタルベース基板 (106)
- ・パワーデバイス用セラミックス基板 (117)
- ・セラミック放熱板(窒化ケイ素) (123)
- ・アルミニウム-シリコンカーバイド放熱板(Al-SiC) (125)
- ・ヒートパイプ (128)
- ・ペルチェモジュール (135)
- ・熱電変換モジュール (142)

《各種放熱材料・基板・デバイスの調査内容》

- 1.製品概要(製品タイプ/アプリケーション分野)
- 2.主要参入企業
- 3.市場規模(2015年)
- 4.市場規模推移予測(2015~2020年)
- 5.主要メーカの事業、技術動向
- 6.製品価格帯

第3章 アプリケーション動向

- ・LED照明 (150)
- ・IGBTモジュール (164)
- ・HEV/EV用パワーコントロールユニット(PCU) (172)

《アプリケーション編》

1. アプリケーション製品の市場規模推移予測
2. 放熱技術の動向
3. 放熱材料・基板・デバイスの採用動向

第4章 メーカー事例研究(187~271)

＜サーマルインターフェース材料＞

デンカ株式会社、Dow Corning Corporation、Henkel AG & Co. KGaA、Laird Technologies Inc.

＜高熱伝導樹脂＞

出光ライオンコンポジット株式会社、住友大阪セメント株式会社、住友ベークライト株式会社、ユニチカ株式会社

＜アルミナフィラー、窒化ホウ素フィラー、窒化アルミニウムフィラー(放熱用)＞

昭和電工株式会社、デンカ株式会社、東洋アルミニウム株式会社、トクヤマ株式会社、古河電子株式会社、株式会社MARUWA、水島合金鉄株式会社、三井化学株式会社、3M Company、H.C. Starck GmbH、Momentive Performance Materials Inc、Saint-Gobain K.K.、ThruTek Applied Materials Inc.

＜メタルベース基板＞

日本発条株式会社、株式会社ダイワ工業、Gia Tzoong Enterprise Co., Ltd.、Henkel AG & Co. KGaA

＜放熱・冷却デバイス/熱電変換デバイス＞

株式会社フジクラ(ヒートパイプ)、株式会社フェローテック(ペルチェ)、株式会社KELK(ペルチェ)、株式会社フェローテック(熱電変換モジュール)、株式会社KELK(熱電変換モジュール)

■ 申込要項

▼ 申込方法:

巻末の申込書に所定事項をご記入の上、弊社宛までFAXお願いいたします。

▼ お支払について:

申込時に請求書を発行いたしますので、請求日の翌月末日までに弊社指定口座にお振込みお願い申し上げます。

申込書

JMS

FAX: 0120-052-807

年 月 日

(株)ジャパンマーケティングサーベイ 行

調査レポート: 放熱材料・基板・デバイスの技術・市場展望 -2016-

該当する□に ✓を入れて下さい

レポートのみ購入 ￥160,000.- (税別)

レポート+CD*を購入 ￥180,000.- (税別)

※レポート+CD購入の場合: 本書下段のCopyrightIに関する約束欄へ署名をお願いします。

企業名: _____

申込希望担当者: _____

所属: _____

役職: _____

E-mail address: _____

申し込み窓口担当者: _____

所属: _____

役職: _____

E-mail address: _____

住所: (〒 _____) _____

TEL: _____ FAX: _____

CopyrightIに関する約束

(社名) _____ は、ジャパンマーケティングサーベイ(以下JMSと略)の調査レポート「放熱材料・基板・デバイスの技術・市場展望 -2016-」の電子データを、JMSの許可なく、第三者へ提供または公開しないことをお約束します。

担当者所属: _____

担当者名(サイン): _____

連絡事項